

実践型セミナーは、実践的な内容に重点を置いた少人数制の「セミナー」で、実際にレーザ加工装置を用いてレーザ加工を体験していただく講習会です。

今年度第2回目の実践型セミナーでは、スペクトロニクス株式会社の協力を得て**高速・高精度な微細穴あけ加工**に関するレーザ実演を実施いたします。

高速・高精度な微細穴あけ加工は、**精密部品、電子部品、医療機器・器具部品**など、多くの産業分野で利用されています。皆様の製造現場の問題解決の場としてご利用いただければ幸いです。**参加費のみでサンプル加工や専門家による技術相談**を受けることができます。是非ご参加ください。

本事業は平成23年度からスタートしたレーザ管理技術者資格認定の対象事業です。



一般社団法人  
レーザプラットフォーム協議会  
第2回実践型セミナー  
ご案内

開催日時： 平成24年2月22日(水) 13:00 ~ 17:30

開催場所： 財団法人 近畿高エネルギー加工技術研究所 エーリック分室  
エーリックビル3F 309号室  
〒660-0083 兵庫県尼崎市道意町7丁目1番3  
TEL:06-6412-7800 <http://www.ampi.or.jp/>

主催： 一般社団法人レーザプラットフォーム協議会

共催： 財団法人 近畿高エネルギー加工技術研究所

協力： スペクトロニクス株式会社

協賛： レーザ加工学会

参加費： レーザプラットフォーム協議会 会員 10,000円  
近畿高エネルギー加工技術研究所 賛助会員、協賛団体 会員 10,000円  
非会員 30,000円

定員： 35名(先着順 定員に達した時点で締め切らせていただきます)

申込方法： 参加申込書に必要事項をご記入の上、FAXにてお申し込みください

#### サンプル加工及び個別の技術相談の申込み方法について

ご希望の方は参加申込書の【サンプル加工】及び【技術相談】欄に○印をご記入下さい。(詳細は下記問合せ先まで)

#### <注意事項>

- ◆サンプル加工の申込みの際には、事前に図面、加工サンプルをお送りいただくことになります。
- ◆サンプル加工の申込みが多数の場合には全ての申込みに対応できない場合がございますので予めご了承ください。
- ◆申込みいただいたサンプル加工につきまして、公開の場でのレーザ実演が難しい場合には事前にご連絡下さい。

スケジュール： ※HPもご覧ください <http://www.laser-platform.com/120222seminar.html>

13:00-13:05 開会あいさつ 大阪大学 接合科学研究所 准教授 阿部信行 氏

13:05-14:20 講演「高速微細穴あけ加工を実現するためのガルバノスキャナを使用した光学設計方法」  
スペクトロニクス株式会社 代表 岡田 穰治 氏

14:30-14:45 加工実演デモ用レーザ装置の紹介 (スペクトロニクス株式会社)

14:45-15:30 レーザ実演1 (デモサンプル加工)

15:30-16:30 レーザ実演2 (受講者サンプル加工)

16:30-16:35 閉会あいさつ 財団法人 近畿高エネルギー加工技術研究所 専務理事 山田 猛 氏

16:35-17:30 近畿高エネルギー加工技術研究所施設見学 (第3高調波レーザ他) → 技術相談のない方は  
見学後解散

※個別技術相談を依頼された企業の相談(個別対応)

\* 技術相談は各講師および事務局が委嘱している専門家が対応します。

お申し込み・お問い合わせ先： 一般社団法人レーザプラットフォーム協議会事務局

〒581-0038 八尾市若林町2丁目91番 (担当:三原、柴崎、森)

TEL:072-948-3550 / FAX:072-948-3560 / E-mail:info@laser-platform.com

## <加工装置・加工事例紹介>

### ■ レーザ発振器



産業用超小型グリーンレーザ  
(3W) 【LVE-G0300】

波長：532nm  
平均出力：3W  
繰返し周波数：～200kHz  
パルス幅：<15ns@50kHz  
モード品質：M2<1.15  
ビーム径：0.6mm

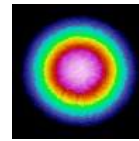


産業用超小型グリーンレーザ  
(6W/10W) 【LVE-G0600/G1000】

波長：532nm  
平均出力：10W  
繰返し周波数：～200kHz  
パルス幅：<23ns@50kHz  
モード品質：M2<1.2  
ビーム径：0.8mm

#### (主な特徴)

- ・完全空冷を実現、メンテナンスの必要がほとんどない。
- ・小型、かつ高い耐環境性を持ち、非常に優れたビーム品質を達成。  
(M2<1.15 TEM00)
- ・薄膜型太陽電池スクライプや、マーキング、金属や樹脂への微細加工に最適。



完全な円ビームによって美しい加工が可能

### ■ レーザ発振器とガルバノスキャナを組み合わせることにより高速かつ高精度微細加工が実現



ガルバノスキャナ  
【QS-7/QS-12】



2軸(X&Y)ガルバノスキャナ  
+ fθ レンズ【Scan Heads】

#### (主な特徴)

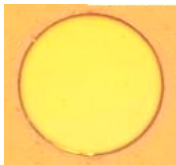
- ・高速スキャンニング
- ・温度ドリフト特性
- ・高い位置再現性

※ナットフィールドテクノロジー株式会社(米国)製

### ■ 加工事例

#### 穴あけ

ポリイミドフィルム



(左) 材質：ポリイミドフィルム  
穴径：φ0.05mm

ガラス



(右) 材質：ガラス 穴径：φ3mm

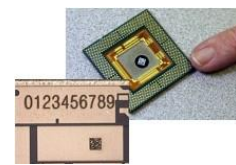
#### レーザスクライピング

(薄膜太陽電池)



スクライピング幅 30μm 以下を実現

#### レーザマーキング



1秒間で775文字の  
印字が可能

### スペクトロニクス株式会社からのメッセージ

スペクトロニクス(株)は、小型で設置自由度が高く、光のオーダーメイドが可能な自社開発レーザ発振器を使ったレーザ加工システムを提案することで、お客様に満足してご使用頂けることを目指しています。レーザ加工を導入検討したいが何を選んでいいのかわからない方、求めているレーザ加工に最適化されたシステムを探されている方、現在のレーザ加工システムで悩みを抱えている方など、是非この機会にお気軽にご相談下さい。加工したいサンプルに最適なレーザ加工装置を検討導入したい企業は必見です！